



Flux sans résidus IF 2005M

INTERFLUX®
ELECTRONICS N.V.



Fiche technique IF 2005M

Ver: 3.12 15-01-16

Flux de brasage sans nettoyage, sans halogènes et sans résidus

Description:

Le flux IF 2005M est un flux sans nettoyage à faible pourcentage de matière solide. Il a été développé pour que tous les constituants du flux s'évaporent lors de process de brasage. C'est le flux de brasage le plus sûr pour des circuits électroniques de haute fiabilité.

L'absence de colophane et de résine dans le flux IF 2005M permet d'obtenir des cartes parfaitement propres et sans résidus collants après brasage, cela garantit une excellente testabilité des cartes au testeur in situ. La pollution de la machine et des cadres de brasage est très faible comparée aux autres flux.

Le flux IF 2005M est garanti sans halogènes. Il passe les tests des normes EN, Bellcore, IPC, Bono et est homologué QPL (MIL-F-14256F). Il a été formulé de façon à obtenir le meilleur compromis entre soudabilité, facilité d'utilisation et fiabilité. Excellente brasabilité sur les finitions HAL, Ni/Au, étain et argent chimique, cuivre passivé (OSP) etc...

Le flux IF2005M est idéal pour le brasage sans plomb. Il résiste très

bien aux températures de préchauffage élevées ainsi qu'au long temps de contact dans les vagues à des températures élevées.

Le flux IF 2005M à une très grande compatibilité avec les vernis de tropicalisation.

Le flux est classé dans la norme IPC J-STD-004 comme OR/L0.

Le flux IF 2005M peut être utilisé dans les stylos rechargeables pour le brasage manuel.



La photo n'est pas contractuelle

Propriétés physiques et chimiques

Apparence	Liquide incolore
Matière solide	1,85% ± 0,15
Densité à 20°C	0,807-0,809 g/ml
Pourcentage d'eau	3-4%
Indice d'acide	14 – 16 mg KOH/g
Point éclair (T.O.C)	15°C (59°F)



Page 1

Informations

Application du flux	2
Préchauffage	2
Contact vague(s)	2
Manipulation	3
Tests de fiabilité	3
Conditionnement	4

Avantages:

- Homologué QPL
- Absolument sans halogènes
- Brasage avec plomb et sans plomb
- Technologie du brasage sans résidus
- Très grande compatibilité avec les vernis de tropicalisation
- Très grande stabilité en fluxeur mousse



Application du flux

Le flux IF 2005M peut être appliqué avec les différentes techniques suivantes.

1. Fluxeur mousse:

Afin d'obtenir une excellente mousse, le niveau de flux dans le fluxeur doit être de 2 à 3 cm au dessus de la pierre poreuse. L'utilisation d'un couteau d'air entre le fluxeur et le préchauffage est impératif.

2. Fluxeur spray:

Nous vous conseillons d'utiliser un spray qui

fluxe la carte à l'aller et au retour. Maintenez une pression de flux basse.

Réglez la vitesse de déplacement de la buse de façon que chaque point est fluxé deux fois (une fois de chaque côté). Ainsi les bandes de fluxage se chevauchent à 50% de leurs largeurs et vous obtiendrez la meilleure répartition possible du flux sous la carte. Utilisez un carton, en lieu et place d'une carte, pour vérifier l'homogénéité du dépôt de flux. Retirez le carton de

la machine avant qu'il n'atteigne le préchauffage.

En complément du carton vous pouvez utiliser une plaque de verre ou un circuit nu qui vous permettront d'évaluer la quantité de flux déposée. Ne pas oublier de les retirer de la machine avant qu'ils n'atteignent le préchauffage.

Idéalement il ne doit pas avoir de gouttes de flux sous la plaque de verre ou le circuit nu. Les gouttes seront difficiles à

évaporer lors du préchauffage.

Réduire la quantité de flux déposé jusqu'à ce que des défauts, typiquement causés par une quantité de flux trop basse, comme des courts circuits, stalactites', etc...apparaissent. Après augmenter la quantité jusqu'à ce qu'ils disparaissent.

3. Stylo:

Pour les retouches et le brasage manuel.

Préchauffage

Le préchauffage, mesuré sur le dessus du circuit, doit être compris entre 80°C et 130°C. Le flux IF 2005M peut accepter des valeurs de préchauffage basses pourvu que les solvants soient totalement évaporés avant le contact avec la vague (s).

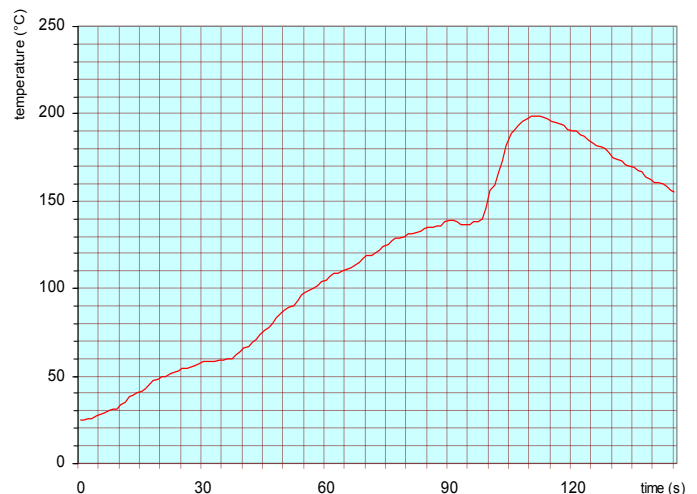
Les paramètres du préchauffage de type con-

vectif ne doivent pas être supérieurs à 150°C. Courbe de préchauffage
Pente standard: 1,5°C/s
Min: 1,0°C/s
Max: 2,5°C/s

Pour les circuits en cuivre passivé, suffisamment de flux, une température de préchauffage modérée et une pression haute de la première vague peut être

bénéficiaire pour les remontées de la sou-

dure dans les trous métallisés.



T° mesurée sur le dessus du circuit sur une machine de brasage à la vague sans plomb

Contact vague(s)

Si vous travaillez en simple vague, le temps de contact standard est de 3-4s. Si vous travaillez en double vague, le temps de contact standard de la première vague est de 1-2s et de 2-4s pour la deuxième vague.

Vous pouvez obtenir un résultat satisfaisant avec

un temps de contact plus court, cependant un temps de contact plus important aura l'avantage de bien éliminer le flux lors du contact vague(s). La limite maximale du temps de contact sera déterminée par l'apparition des ponts et les propriétés physiques de la carte et des composants.



Manipulation

Stockage

Le flux doit être stocké dans les bidons d'origines fermés, à des températures entre +5° to +25°C

Sécurité

Toujours lire la fiche de sécurité du produit.

Contrôle de densité

La densité du flux IF 2005M peut être mesurée à l'aide d'un densimètre et un thermomètre pour le contrôle de la température. Si cela est nécessaire vous pouvez ajuster la densité du flux à l'aide du diluant T 2005M. En vous aidant du tableau de dilution. Utilisez uniquement le diluant T 2005M pour diluer le flux IF 2005M.

Mesure de titration

La mesure de la quantité de matière solide du flux IF 2005M peut être faite à l'aide d'une titration. Les liquides de titration sont disponibles chez Interflux. Si cela est nécessaire ajustez la quantité de matière solide à l'aide du diluant T 2005M en vous aidant du tableau de titration.

Réutilisation

Ne pas mélanger du flux usage avec du flux neuf.

Résultats des tests de fiabilité

Conformes aux normes EN 61190-1-2(2002) et IPC J-STD-004B

Tests	Résultats	Méthodes
Chimique		
Classification du flux	OR LO	J-STD-004B
Miroir de cuivre	passe	J-STD-004B IPC-TM-650 2.3.32
Présence d'halogènes		
Chromate d'argent (Cl, Br)	passe	J-STD-004B IPC-TM-650 2.3.33
Quantité d'halogènes	0,00%	J-STD-004B IPC-TM-650 2.3.35
Environnement		
Test SIR	passe	J-STD-004B IPC-TM-650 2.6.3.7
Test de corrosion	passe	J-STD-004B IPC-TM-650 2.6.15
Test d'électromigration (chimique)	passe	Bellcore GR-78-CORE section 13.1.4
Test d'électromigration (chimique)	passe	Siemens ZT



Conditionnement:

Le flux IF 2005M est disponible en conditionnement suivant:

Bidon de 10 litres en polyéthylène

Bidon de 25 litres en polyéthylène

Bidon de 200 litres en polyéthylène

Nom commercial du produit : IF 2005M No-Clean, Halide Free Soldering Flux

CLAUSE

Du fait qu'Interflux® Electronics N.V. ne peut pas prévoir ou contrôler les différentes conditions dans lesquelles ces informations et nos produits sont utilisés, nous ne donnons pas de garantie concernant l'exactitude de cette description ou l'aptitude de nos produits dans certaines situations données. Les utilisateurs de nos produits doivent effectuer leurs propres tests afin de déterminer que chaque produit convient à l'objectif fixé. Par conséquent, le produit en question est vendu sans cette garantie.

Copyright:

INTERFLUX® ELECTRONICS

Consultez la dernière version de ce document sur:

www.interflux.com/fr

Le document dans une autre langue?:

www.interflux.com